

はんだ量の不足が予測されるランドに『チップソルダー』を

"Chip solder" for lands where a lack of solder is anticipated

特長

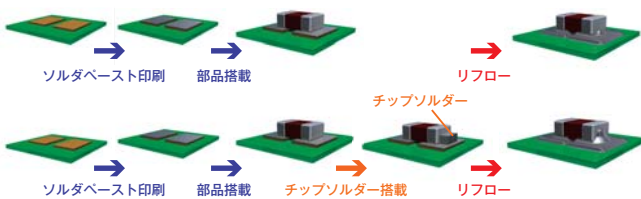
はんだ量の不足が予測される実装に0402サイズもラインナップ

- SMDと同時に自動搭載可能なテーピング仕様
- ソルダペーストと同時に溶融、追いはんだ付けが不要
- 適切なはんだ量の供給で、高い接続信頼性を確保



製品仕様

□ チップソルダーを自動搭載、同時溶融

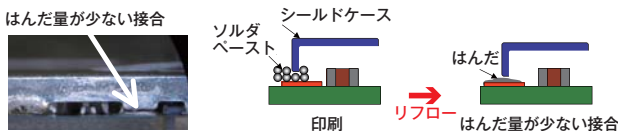


□ 大型部品の接合補強に

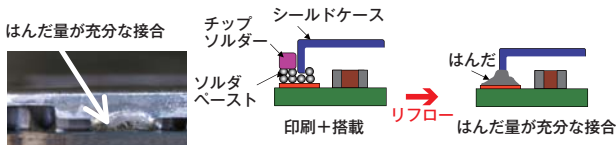


□ シールドケースの接合補強に

従来の方法

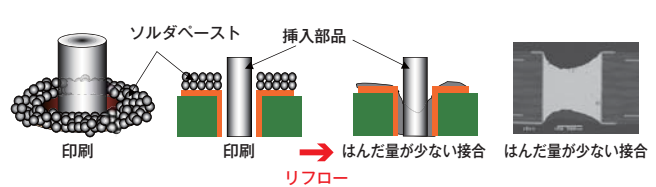


チップソルダーではんだを補充

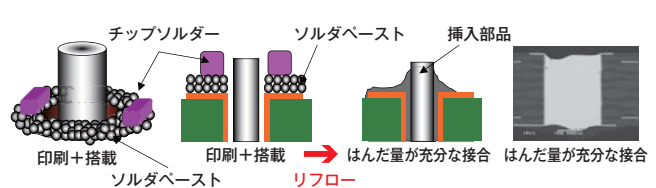


□ リフローでの挿入部品の接合補強に

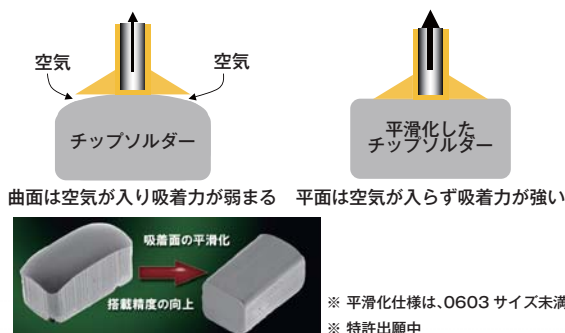
従来の方法



チップソルダーではんだを補充



□ 吸着面を平滑にして搭載精度を向上



Sh-Semi12-07J

□ チップソルダー寸法公差

(単位 : mm)

	l	w	t
0402	±0.05	±0.05	±0.05
05025	±0.05	±0.05	±0.05
0603	±0.1	±0.1	±0.05
1005	±0.1	±0.1	±0.05
1608	±0.1	±0.1	±0.05